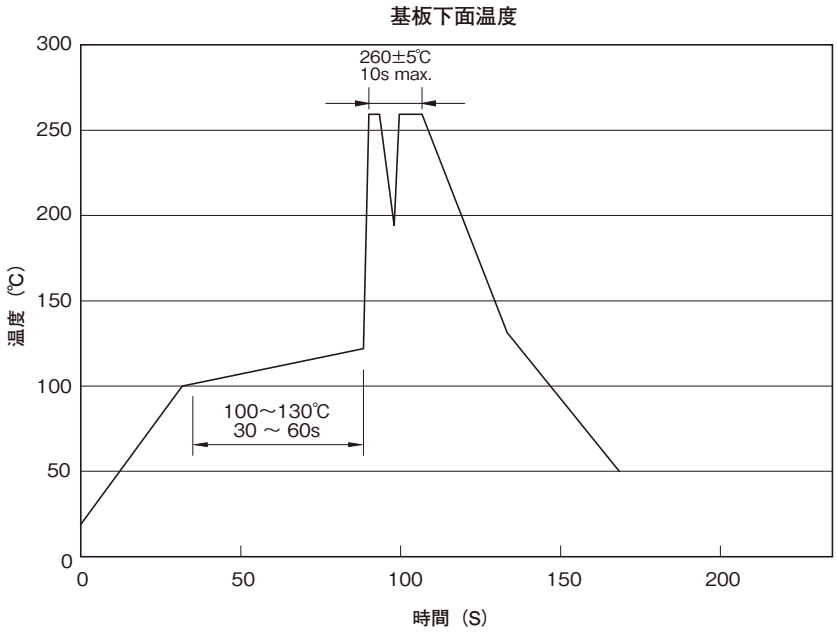
■はんだ付け推奨条件（鉛フリー）

●リード線端子品（導電性高分子ハイブリッド）アルミニウム電解コンデンサ

（1）はんだごて条件
こて先温度400°C±5°C，時間3$^{+1}_{0}$秒以内として下さい。

（2）フローはんだ付け条件
下記のグラフの条件以下ではんだ付けが可能です。



はんだ付け時の注意事項

(1) コンデンサ本体を溶融はんだに浸漬しないで下さい。
(2) フラックスは、はんだ付けする面のみ塗布して下さい。
(3) スリーブが直接基板および他の金属部分に接触している場合、スリーブの収縮や割れが発生することがあります。
(4) 機器の長期使用の場合，実装はんだ付け不良によってコンデンサとプリント配線板等の接続不良を起こし異常電流が流れることのないように，はんだ付け特性を管理してご使用下さい。
(5) 詳しくは使用上の注意事項および納入仕様書を参照して下さい。

・改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
・ご使用及びご注文の際には，当社「納入仕様書」をご要求いただき，それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。

はんだ付け条件

チップ形（導電性高分子ハイブリッド）
アルミニウム電解コンデンサ

ELNA

■はんだ付け推奨条件（鉛フリー）

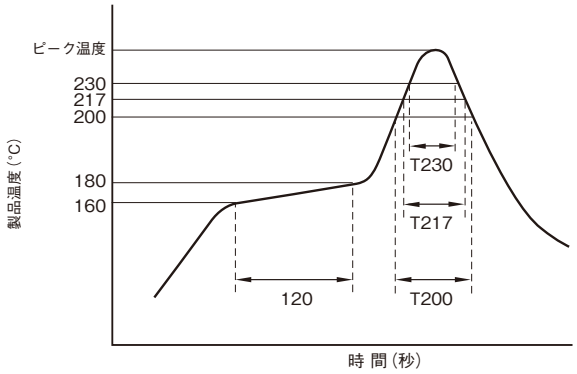
● チップ形（導電性高分子ハイブリッド）アルミニウム電解コンデンサ

（1）はんだごて条件

こて先温度400℃±5℃，時間3$^{+1}_{0}$秒以内として下さい。

（2）リフローはんだ付け条件

プロファイル



1. プリヒートは180℃以下で120秒以内として下さい。
2. ピーク温度は下表以内として下さい。
3. 許容範囲をこえる場合は，弊社までご相談下さい。

T200：コンデンサ頭部の温度が200℃をこえる時間（秒）
T217：コンデンサ頭部の温度が217℃をこえる時間（秒）
T230：コンデンサ頭部の温度が230℃をこえる時間（秒）
温度測定部：ケーストップ

● 導電性高分子ハイブリッド　チップ形アルミニウム電解コンデンサ

シリーズ	サイズ	ピーク温度（5秒以下）	T230	T217	T200	リフロー回数
HV1, HVK, HVX, HVQ, HT1, HTK, HTX, HTQ, HVY, HVL, HTY, HTL	φ5 ～ φ6.3	250℃ Max.	40秒　以内	50秒　以内	60秒　以内	2回　以下
	φ8 ～ φ10	240℃ Max.	40秒　以内	50秒　以内	60秒　以内	2回　以下
	φ12.5	240℃ Max.	20秒　以内	30秒　以内	50秒　以内	2回　以下

● チップ形アルミニウム電解コンデンサ

シリーズ	サイズ	ピーク温度（5秒以下）	T230	T217	T200	リフロー回数
VV5, VVB, VVS, VVR, VVC, VZH, VVZ, VVD, VVV, VZD, VZK, VVT, VZJ, VZF, VZE, VVX, VV9, VVM, VVG	φ4 ～ φ6.3	250℃ Max.	40秒　以内	50秒　以内	60秒　以内	2回　以下
	φ8 ～ φ10	240℃ Max.	40秒　以内	50秒　以内	60秒　以内	2回　以下
	φ12.5	240℃ Max.	20秒　以内	30秒　以内	50秒　以内	2回　以下
VZA, VZB, VZC	φ4 ～ φ6.3	260℃ Max.	40秒　以内	90秒　以内	—	2回　以下
	φ8 ～ φ10	250℃ Max.	40秒　以内	90秒　以内	—	2回　以下
VTZ, VTD, VTT, VTQ, VTV, VMH, VMD, VMJ, VMF, VME, VTX	φ6.3	250℃ Max.	40秒　以内	60秒　以内	80秒　以内	2回　以下
	φ8 ～ φ10	250℃ Max.	30秒　以内	60秒　以内	80秒　以内	2回　以下
	φ12.5 ～ φ18	240℃ Max.	20秒　以内	30秒　以内	50秒　以内	2回　以下

*2回目のリフローを行う場合は，1回目のリフロー後に，必ずコンデンサの温度が室温（5 ～ 35℃）まで充分に冷えたことをご確認の上，行って下さい。

・改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
・ご使用及びご注文の際には，当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。